三井金属

2019年6月4日

各　位

高周波基板用電解銅箔「VSP®」の増産起業完了

～ 台湾工場の生産能力を最大2.4倍（最大420ｔ/月体制）に増強 ～

当社（社長　西田計治）は、高周波基板用銅箔「VSP®」の増産起業が完了し、稼働を開始致しましたのでお知らせいたします。

当社の高周波基板用銅箔「VSP®」は、優れた表面平滑性と微細粗化処理により、高周波数帯におけるプリント基板の伝送損失低減に大きく寄与することから、お客様より高い評価を得ております。

VSP®は2018年4月に台湾工場（台湾銅箔股份有限公司）において現有設備の一部改造と電解設備の新設により生産能力を175ｔ/月体制から275ｔ/月体制へと引き上げる設備増強を行いました（2017年7月20日プレスリリース）。この工事期間中に更なる需要増が見込まれたため、この電解設備新設の設備増強に加え、一般箔の現有設備をフレキシブルに転用可能にする設備改造も合わせて追加実施し、VSP®を最大420t/月まで製造可能な増産起業として2019年5月末に完了致しました。この度の増産起業により、スマートフォンの5G運用開始やSociety5.0、CASE時代における自動運転やコネクティドカーを背景とした旺盛な需要に十分対応する体制が整いました。

当社のスローガンである「マテリアルの知恵を活かす」のもと、安定した品質を維持し、お客様への十分な供給能力を確保してまいります。

以　上

【お問い合わせ先】
三井金属　経営企画本部　広報部　　TEL 03-5437-8028　　FAX 03-5437-8029
Eﾒｰﾙ　PR@mitsui-kinzoku.com

一般銅箔

VSP®

写真　アップルマンゴーが映り込んだ銅箔の表面

※VSP®は、鏡面のような優れた表面平滑性が特徴

（ご参考）

VSP®の主な用途：通信インフラ機器（サーバー、ルーター、基地局など）などの高周波基板用銅箔

台湾銅箔股份有限公司について

（1）名称	：台湾銅箔股份有限公司
（2）所在地	：中華民国台湾省南投県南投市
（3）董事長	：須戸　達哉
（4）設立	：1980 年 11 月
（5）資本金	：800 百万元
（6）出資者	：当社 95%
（7）事業内容	：プリント配線板用銅箔の製造